

# BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂对CaZrO<sub>3</sub>陶瓷介电性能的影响

孙换,李谦,黄金亮,顾永军

(河南科技大学 材料科学与工程学院,河南 洛阳 471003)

**摘要:**研究了BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量对CaZrO<sub>3</sub>陶瓷烧结性能、物相组成、介电性能和微观组织形貌的影响。结果表明,通过掺杂BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>,可使CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的烧结温度由1500℃降至1000℃,且无第二相生成,相对密度达98%。当w(BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>)=7.5%时,CaZrO<sub>3</sub>陶瓷在1000℃烧结3 h获得良好的介电性能:介电常数ε<sub>r</sub>=28,品质因数与频率之积Q·f=8 872 GHz,频率温度系数τ<sub>f</sub>=21×10<sup>-6</sup>/℃。

**关键词:**微波介质陶瓷;CaZrO<sub>3</sub>陶瓷;介电性能;低温烧结;液相烧结;BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>

中图分类号:TN304;TQ174 文献标识码:Α

## Effect of BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub> Doping on Dielectric Properties of CaZrO<sub>3</sub> Microwave Dielectric Ceramics

SUN Huan, LI Qian, HUANG Jinliang, GU Yongjun

(School of Material Science and Engineering, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471003, China)

**Abstract:** Taking BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub> as the liquid phase sintering assistants, the effects of BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub> doping on the sintering, phase compositions, microstructure morphology and dielectric properties of CaZrO<sub>3</sub> ceramics were investigated. The result indicated that BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub> could be used as sintering assistants to reduce the sintering temperature of CaZrO<sub>3</sub> ceramics from 1500℃ to 1000℃ without second phase formation. When the mass fraction of BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub> was 7.5%, a high relative density of 98% and good dielectric properties of ε<sub>r</sub>=28, Q·f=8 872 GHz, τ<sub>f</sub>=21×10<sup>-6</sup>/℃ were obtained for the CaZrO<sub>3</sub> ceramics sintered at 1000℃ for 3 h.

**Key words:** microwave dielectric ceramics; CaZrO<sub>3</sub> ceramics; dielectric property; low temperature sintering; liquid phase sintering; BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>

## 0 引言

近年来,低温共烧陶瓷技术(LTCC)用作微波元器件的小型化、集成化与低成本化得到了广泛的发展,对以微波介质陶瓷为基础的微波元器件提出了更高的要求。LTCC技术要求微波介质陶瓷材料的烧结温度低于1000℃,且与电极材料Ag(熔点960℃)、Cu(熔点1 084℃)等共烧且不发生化学反应<sup>[1]</sup>。为满足此要求,需研制能与高电导率Ag或Cu电极共烧的LTCC微波介质陶瓷<sup>[2]</sup>。

CaZrO<sub>3</sub>微波介质陶瓷具有高的介电常数和低的介电损耗,可用于微波条件下的电容器和介质谐振器,具有很好的实用价值。在传统固相合成工艺下,CaZrO<sub>3</sub>的介电常数ε<sub>r</sub>≈30,在频率f=5.6 GHz时的品质因数Q≈3 000,温度频率系数τ<sub>f</sub>=-26.5×10<sup>-6</sup>/℃。然而,CaZrO<sub>3</sub>的烧结温度通常高于1550℃,远高于Ag(960℃)或Cu(1 084℃)

的熔点,不能实现电极共烧,因此降低材料的烧结温度很重要。

通过添加低熔点玻璃或氧化物以实现材料低温烧结是一种行之有效的方法。Woo-Jin Lee等<sup>[3]</sup>添加质量分数5%的玻璃料(含MnO<sub>2</sub>、CaCO<sub>3</sub>、MgCO<sub>3</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和SiO<sub>2</sub>)到CaZrO<sub>3</sub>陶瓷中,使烧结温度降低200~350℃,实现了与镍电极(1 453℃)的低温共烧;Bok-Hee Kim等<sup>[4]</sup>添加质量分数1%的玻璃料(含CaO、MgO、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>)到(1-x)CaZrO<sub>3</sub>-0.1SrTiO<sub>3-x</sub>TiO<sub>2</sub>陶瓷系中,使烧结温度降低在1 300℃以下,ε<sub>r</sub>由41.2增加到63.0。但其研究的烧结温度仍过高。因此,如何进一步降低CaZrO<sub>3</sub>陶瓷烧结温度值得深入研究。微波介质陶瓷材料的低温烧结机理以液相促进烧结为主,液相的产生主要是添加物本身是低熔点物质。BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>熔点为690℃<sup>[5]</sup>,熔点低,加入到陶瓷粉中,可与陶瓷粉

收稿日期:2014-07-15

基金项目:河南省国际科技合作计划基金资助项目(0346620012),河南省科技发展计划基金资助项目(092300410135)

作者简介:孙换(1988-),女,河南省新乡人,硕士生,主要从事微波介质陶瓷材料的研究。E-mail: yyfsh2012@163.com。李谦(1963-),男,河南省洛阳人,副教授,硕士,主要从事微波介质材料的研究。E-mail: liqian@haust.edu.cn。

形成低共熔点化合物,促进液相烧结,以此降低陶瓷的烧结温度。但 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 作为氧化物助烧剂添加到陶瓷中降低烧结温度的报道未曾见到,因此本实验通过添加 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 到 $\text{CaZrO}_3$ 中,研究了其对 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷粉体烧结性能和介电性能的影响。

## 1 实验

### 1.1 样品制备

将分析纯的 $\text{BaCO}_3$ 、 $\text{H}_3\text{BO}_3$ 、 $\text{Bi}_2\text{O}_3$ 粉料按 $m(\text{BaCO}_3) : m(\text{H}_3\text{BO}_3) : m(\text{Bi}_2\text{O}_3) = 1 : 6 : 5$ 配料,用酒精作介质球磨24 h,取出干燥研磨后,采用传统固相反应法在460 °C煅烧24 h制备 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 粉体。然后分别将质量分数为2.5%、5%、7.5%、10%的 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 加入 $\text{CaZrO}_3$ 粉体中,以无水乙醇为介质,ZrO<sub>2</sub>球球磨24 h,干燥备用。将得到的 $\text{CaZrO}_3$ 粉体在156 MPa下压成Φ10 mm×3 mm的圆片,经900~1 050 °C烧结3 h。

### 1.2 表征

用Archimedes排水法测量 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷的体积密度;用德国电子公司生产的D8X线衍射仪分析其相组成;用JSM-5610LV型扫描电镜观察表面形貌;用Agilent公司N5230C-220矢量网络分析仪采用闭腔法测量微波介电性能。谐振频率温度系数为

$$\tau_f = \frac{f_2 - f_1}{f_1(T_2 - T_1)} \quad (1)$$

式中: $f_1$ 为20 °C时试样的谐振频率; $f_2$ 为80 °C时试样的谐振频率; $T_1 = 20$  °C; $T_2 = 80$  °C。

## 2 结果与分析

### 2.1 烧结特性分析

图1为 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷添加不同的 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 含量后在900~1 050 °C烧结3 h所得样品的体积密度曲线。由图可看出,当添加量一定时,随着烧结温度的提高,掺杂 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 的 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷的相对体积密度都先变大后略下降,当 $w(\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}) = 7.5\%$ ,1 000 °C烧结3 h的 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷获得最大相对密度为98%。这是由于 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 的软化点(350 °C)低,在较低度下产生大量液相,而有液相参与的流动传质比固态烧结扩散传质快,因而陶瓷烧结温度降低。但当液相量过多时,过多的液相在烧结过程中挥发,增加样品的孔隙率,降低致密度,因此, $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 的添加量要适当。

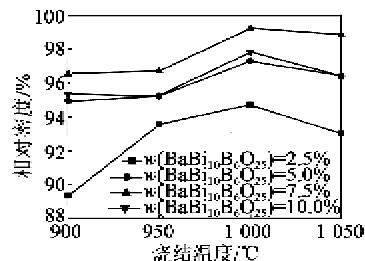


图1 添加 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 的 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷在不同烧结温度下的相对体积密度

### 2.2 物相组成分析

图2为添加不同 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 在1 000 °C下烧结3 h的 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷的XRD谱。由图可看出,其主晶相均为钙钛矿结构 $\text{CaZrO}_3$ 相,另有少量的 $\text{ZrO}_2$ 相存在。图中未发现 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 的相关相成分,添加的 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 烧结助剂主要以玻璃相的形式存在,并未析晶或参与晶相反应,仅起液相助烧作用。这与掺杂ZBS玻璃的 $\text{CaZrO}_3$ <sup>[6]</sup>、 $\text{Ba}_2\text{Ti}_3\text{Nb}_4\text{O}_{18}$ <sup>[7]</sup>、 $\text{Zn}_2\text{SiO}_4$ <sup>[8]</sup>陶瓷类似。说明 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 在烧结过程中生成的液相,在冷却过程中未析出,而是以玻璃的形式存在于晶界处,且 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 在烧结过程中并未参与反应。这说明添加 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 对 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷的相成分无影响,可作为有效助烧剂来降低 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷的烧结温度。

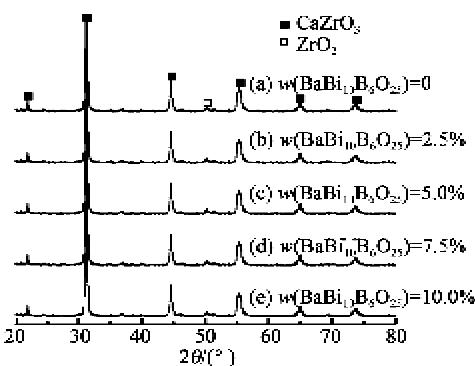


图2 添加不同 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 的 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷的XRD谱

### 2.3 显微结构分析

图3为不同 $\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}$ 掺杂量的 $\text{CaZrO}_3$ 陶瓷在1 000 °C下烧结3 h的陶瓷样品表面SEM照片。由图可知,当 $w(\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}) = 2.5\%$ 和5%时,样片晶粒发育状况较差,晶粒细小,气孔多,排列较疏散,这是因陶瓷在烧结过程中液相量不足,无法达到致密化(见图3(a)、(b))。 $w(\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}) = 7.5\%$ 的样片晶粒间排列较紧密,晶粒尺寸均一,气孔基本排除,陶瓷体烧结致密。而当 $w(\text{BaBi}_{10}\text{B}_6\text{O}_{25}) =$

10%时,晶粒已出现异常长大,气孔含量增加。研究表明,适量掺杂BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>能降低CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的烧结温度,有利于烧结时气孔的排除,推动晶粒均匀长大,促进材料更致密,但BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>量过多时,会引起气孔增多,并有玻璃相的存在,导致材料的介电性能恶化。

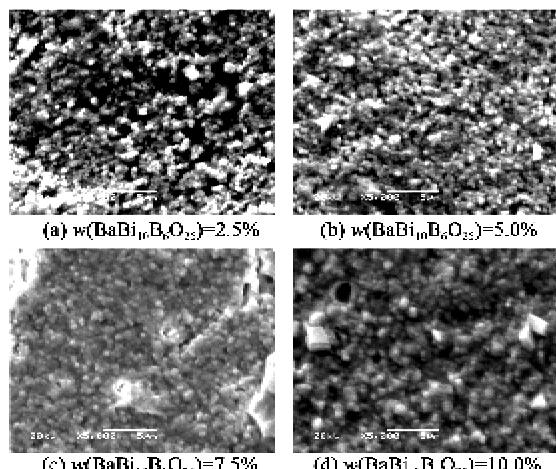


图3 不同BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的SEM

## 2.4 微波介电性能分析

图4为不同BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的CaZrO<sub>3</sub>陶瓷在1000℃下烧结的 $\epsilon_r$ 及Q·f值曲线。

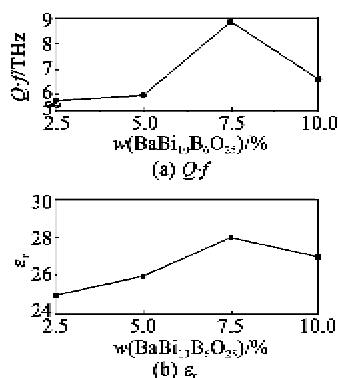


图4 不同BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的 $\epsilon_r$ 及Q·f值

由图4可看出, $\epsilon_r$ 随着BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的增加先增大后减小变化趋势与相对密度一致,这是于微波介质陶瓷致密度的高低在一定程度上决定了其 $\epsilon_r$ 的大小,陶瓷致密度越大,单位体积参与极化的质点数越多,因此 $\epsilon_r$ 也越大。当w(BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>)=7.5%,CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的 $\epsilon_r$ 达最大( $\epsilon_r=28$ )。对于微波介质材料来说,其在微波频率下的介电损耗tan $\delta$ 包括本征损耗和非本征损耗<sup>[9]</sup>。本征损耗产生于晶格的非谐声子衰减过程,而非本征损耗则由晶体的

缺陷(包括晶格畸变、杂质原子、空位等)、位错、晶界、第二相、气孔等造成。由图4还可看出,样品的Q·f值随着BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的增加先增大后减小,在w(BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>)=7.5%时达极大值(Q·f=8872 GHz)。添加BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>和ZBS在烧结时形成液相,增强烧结过程中的传质过程,进而促进了致密化,使材料中的气孔数量和尺寸减小,降低了介电损耗。同时,随着BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的进一步增加,BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>-CaZrO<sub>3</sub>陶瓷晶粒异常生长及气孔数量增加,导致介电损耗增加。

图5为不同BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的CaZrO<sub>3</sub>陶瓷在1000℃烧结时的 $\tau_f$ ,由图5可看出,样品的 $\tau_f$ 随BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的增加而变大,在w(BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>)=7.5%时, $\tau_f$ 为 $21 \times 10^{-6}/\text{℃}$ 。这可能是与BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>本身有关。综合以上,当w(BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>)=7.5%时,CaZrO<sub>3</sub>陶瓷在1000℃烧结3 h获得良好的介电性能: $\epsilon_r=28$ ,Q·f=8872 GHz, $\tau_f=21 \times 10^{-6}/\text{℃}$ 。虽然该温度仍高于银的熔点,但添加BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>使CaZrO<sub>3</sub>陶瓷可与铜电极共烧。而这样的微波介电性能和烧结温度,基本可满足LTCC理论应用需求。

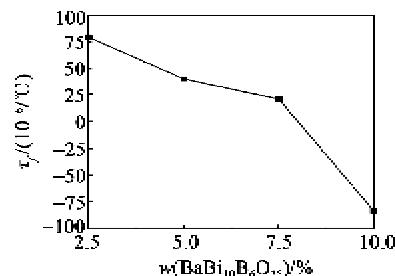


图5 不同BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>掺杂量的CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的 $\tau_f$

## 3 结论

1) BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>可使CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的烧结温度从1550℃降低到1000℃,且相对密度达98%,优于添加ZBS玻璃的CaZrO<sub>3</sub>陶瓷<sup>[6]</sup>,更有助于CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的低温烧结致密化。

2) 当w(BaBi<sub>10</sub>B<sub>6</sub>O<sub>25</sub>)=7.5%时,CaZrO<sub>3</sub>陶瓷在1000℃烧结3 h获得良好的介电性能: $\epsilon_r=28$ ,Q·f=8872 GHz, $\tau_f=21 \times 10^{-6}/\text{℃}$ ,与添加ZBS玻璃的CaZrO<sub>3</sub>陶瓷的介电性能( $\epsilon_r=25$ ,Q·f=8584 GHz, $\tau_f=-45 \times 10^{-6}/\text{℃}$ )相比,略有提高,性能保持良好。

(下转第276页)